

* 本資料は、欧州(現地時間 2012 年 2 月 24 日)にて発表した内容の抄訳です。

2012 年 2 月 27 日

フェリカネットワークス株式会社

モバイル業界における世界最大の展示会 「Mobile World Congress 2012」に初出展

～モバイル機器と非接触 IC 技術で創る便利で楽しい世界の創造をグローバル市場でもサポート～

フェリカネットワークス（本社：東京都品川区、代表取締役社長 杉山博高、以下フェリカネットワークス）は、2 月 27 日からバルセロナで開催予定のモバイル業界における世界最大の展示会「Mobile World Congress 2012」（以下 MWC）に初出展します。

展示ブース内では、携帯電話と非接触 IC 技術を融合させて、世界で初めて商業化・普及を実現した「おサイフケータイ®サービス」の紹介とデモを行います。あわせて、世界標準規格の策定が進み、普及しつつある近距離無線通信技術 Near Field Communication（以下 NFC）への取り組みについて、展示を行う予定です。

2004 年、日本では世界に先駆けて携帯電話と非接触 IC 技術を融合させたサービスが開始し、通信会社、セット/デバイスメーカー、システム構築およびサービス事業者が一体となり、急速な普及に成功しました。その結果、携帯電話の中に取り込んだ電子マネー、クレジットカード、交通乗車券、コンサートチケット、会員証、クーポン、入館証や鍵の認証などの様々な機能を、携帯電話をかざすだけで、便利に、楽しく使える生活インフラが構築され、今もサービスが拡大しています。

当社は、おサイフケータイサービスの実現、普及にあたり、チップの開発からライセンス提供、プラットフォーム運営、サービス導入支援・サポートまでを一気通貫で事業者提供して参りました。当社は、8 年にわたる事業経験で培った、チップ開発の技術・プラットフォームサービス運用のノウハウを、普及が急速に進むスマートフォンと NFC との融合に生かすことで、更なるサービスの進化を図ってまいります。また、国際ローミングなど通信のグローバル化が進む中、グローバル展開を行う企業に、スマートフォンと NFC による新しいサービスの可能性を広げ、新たなサービス展開のサポートを目指します。

フェリカネットワークスが開発した「モバイル FeliCa IC チップ」を搭載した携帯電話は、日本国内で 2011 年には約 7000 万台となりました。2012 年 1 月、Androd 搭載スマートフォンは、累計出荷 1000 万台を突破しています。こうした順調なモバイル FeliCa の普及に伴い、より安定的に、付加価値の高い技術とサービスを提供してきた当社は、NFC 市場に期待する世界中の沢山の企業へ、モバイル機器を使った便利で楽しい、革新的な世界の創造のため、常に新しい技術・サービスが活用できる環境を提供していく所存です。

※NFC とは：13. 56MHz の周波数を利用する通信距離 10cm 程度の近距離無線通信技術です。非接触 IC カードの通信および機器間相互通信が可能で、機器を近づけることで通信を行うため、「かざす」動作をきっかけにした、わかりやすい通信手段として注目を集めています。非接触 IC カード技術規格である ISO/IEC14443 Type A/B、及び FeliCa の通信方式に対応しています。NFC は近距離無線通信の国際標準規格である ISO/IEC 18092 として規定されています。

※FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カード技術です。

※FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。

※おサイフケータイは株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

モバイル業界における世界最大級の展示会 Mobile World Congress 2012

概要:

携帯電話・モバイル業界の世界最大級のビジネスイベント。世界の主要携帯電話通信事業者、無線機器および端末メーカーをはじめコンテンツ/サービス、ソフトウェア開発、周辺機器、関連の企業などの関係者が参加。期間中は展示会に加え、会議、セミナー等も開催される。2010年から、「App Planet」と呼ばれる、アプリ開発者が参加するセミナーも開催する予定。

開催地(会場): スペイン バルセロナ “Fira de Barcelona”
Av. Reina Maria Cristina, s/n, 08004 Barcelona, Spain.

開催日程: 2012年2月27日(月)~2012年3月1日(木) (4日間)

会場時間: 9時~19時 (最終日のみ16時終了)

来場実績: 6万人以上 (2011 MWC)

出展者実績: 1,400社以上 (2011 MWC)

主催: GSM Association

公式HP: <http://www.mobileworldcongress.com/>

※入場には、MWC事務局から入場パスをご購入いただく必要がございます。
<http://www.mobileworldcongress.com/passes-and-prices>



全体

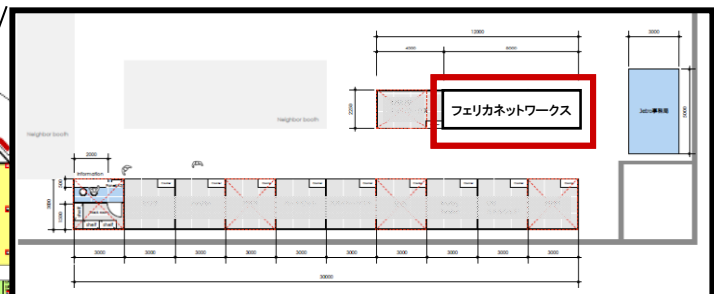


Hall 7

■フェリカネットワークスはHall7のJETRO(独立行政法人日本貿易振興機構)が主催する“Japan Pavilion”ブース内にて出展致します。

世界に先駆けて普及しております日本のおサイフケータイの端末インフラやサービスの拡がりをご紹介すると共に、弊社のCRMソリューションである「かざすフォルダ」や「リアル送客アフィリエイトサービス」についての展示を行います。またNFCに向けた取り組みについてもご紹介する予定です。

Hall 7 Japan Pavilion



MWC では、当社のグローバル市場における事業展開と NFC に関する取り組みについて、以下の内容を表明します。

① NFC 対応チップの開発

当社は、NFC に対応したチップを半導体メーカーと協力し、2012 年の商品化を目指し、開発しています。同チップは、FeliCa および他の非接触 IC カード通信方式にも対応するものです。

当社は、既存のソニー株式会社、ルネサスエレクトロニクス株式会社、株式会社東芝に加え、この度、2013 年の商品化を目指し、非接触 IC チップの半導体メーカーとしてグローバル市場を牽引するオランダの NXP セミコンダクターズ、および半導体、携帯電話、デジタル機器分野におけるグローバルなリーディングカンパニーであるサムスン電子をパートナーに協業して参ります。当社は、本パートナーシップにより、通信会社、携帯電話／各種端末メーカーなどグローバルな NFC サービス市場で事業を展開する企業への NFC 対応チップ提供体制を強化します。

② NFC 対応サービスプラットフォームの提供

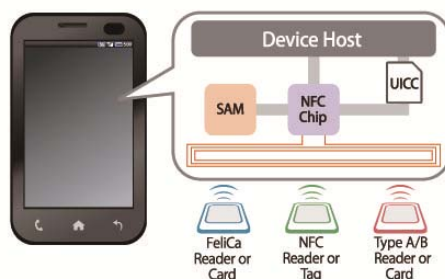
当社は、NFC 対応チップの提供に加え、Type A/B のサービスにも対応した NFC サービス対応プラットフォームの提供を 2012 年を目途に行います。

③ グローバル展開をサポート

NFC が普及することにより、おサイフケータイで実現しているような便利なサービスが、世界中で提供が可能になります。当社は、NFC の対応チップの提供はもちろん、迅速なサービスの立ち上がりにあたっては、当社提供の NFC-FeliCa のプラットフォームサービスによる提案も可能です。当社は、上記①②の取り組みにより、通信業者に加え、様々な企業のグローバル市場でのサービス展開環境をサポートすべく、ソリューションの提供も視野に入れて活動して参ります。

FeliCa & Type A/B Capable Total Solutions

- Development of NFC Chip complying with ISO/IEC 14443/18092
- Expansion of Service Platform



※SAM: Secure Application Module, UICC: Universal Integrated Circuit Card